

华泰联合证券有限责任公司
关于江苏艾森半导体材料股份有限公司
2026 半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：艾森股份
保荐代表人姓名：石伟	联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：张帅	联系电话：021-38966588

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票의 保荐机构，对艾森股份进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

二、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、市场竞争风险

基于下游市场需求，发行人围绕电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大业务板块推出多款产品，其他国内竞争对手也在持续增加研发投入、扩建产能或推出新产品参与市场竞争。同时，半导体下游客户对电镀液、光刻胶等产品的可靠性和稳定性要求极高，更换供应商难度较大，公司与国际巨头争夺高端市场，面临无法抢占其市场份额的竞争风险。如果公司不能根据市场需求持续更新技术

和开发产品、降低产品成本、保持产品和技术竞争力，公司可能无法与国内外企业进行有效竞争，从而对公司的市场份额、市场地位、经营业绩造成不利影响。

2、新产品研发风险

半导体材料属于技术密集、资金密集型行业。近年来全球半导体产业向先进制程、先进封装、超高纯度方向快速演进，下游晶圆制造、封测及显示面板厂商为保障生产良率与工艺稳定性，对上游材料供应商的产品提出了更高的技术指标要求和新产品研发制造要求。

公司新产品研发需经过研发立项、需求确认、产品设计及实验室小试、样品试制及研发验证、中试及产品认证等多个核心环节，研发周期较长、资金与人力投入规模较大。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发制造失败的风险，若公司不能按计划完成新产品的开发，或者所开发的新产品在性能、质量或成本方面不具有竞争优势，将对公司的盈利能力以及在行业内的竞争地位造成不利影响。

（二）经营风险

1、毛利率波动风险

受产品结构及原材料价格等因素的影响，公司主要产品毛利率存在小幅波动。若未来市场竞争加剧、新产品开发失败等因素导致产品价格下降，产品结构发生重大不利变动或原材料价格上涨，公司将面临毛利率下滑的风险，从而对经营业绩造成不利影响。

2、原材料供应及价格上涨的风险

公司原材料主要包括各种溶剂类和固体类的化工原料，以及以锡材（锭）为主的金属材料。上述材料作为大宗工业原材料，其价格易受国际原油价格或国际金属价格的波动影响。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）行业风险

1、半导体行业周期变化风险

半导体行业具有较强的周期性特征，与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体行业的市场需求也将随之受到影响；下游市场的波动和低迷亦会导致对电子化学品需求的下降。若全球经济增速放缓、AI算力需求不及预期，或消费电子、汽车电子等下游市场再度疲软，将直接导致半导体产品需求下滑，进而影响公司光刻胶、电镀液等核心材料的订单量与产品价格。如果由于贸易摩擦等因素引致下游市场整体波动，亦或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，将对包括公司在内的行业内企业的经营业绩造成一定的影响。

三、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2026年上半年，公司主要财务数据及指标如下表所示：

单位：万元

主要财务数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	增减幅度
营业收入	34,605.33	27,989.29	23.64%
归属于上市公司股东的净利润	2,183.59	1,678.20	30.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,045.05	1,443.67	41.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,225.18	2,285.09	-2.62%
主要财务数据	2026 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	增减幅度
归属于上市公司股东的净资产	104,973.58	99,220.61	5.80%
总资产	139,276.62	133,236.21	4.53%
主要财务数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	增减幅度
基本每股收益（元 / 股）	0.18	0.14	28.57%
稀释每股收益（元 / 股）	0.18	0.14	28.57%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.17	0.12	41.67%

加权平均净资产收益率（%）	2.10	1.71	增加 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.96	1.47	增加 0.49 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.15	10.87	增加 2.28 个百分点

注：上年同期基本每股收益按调整后的股数重新计算。

1、报告期内，公司实现营业收入34,605.33万元，同比增长23.64%。受益于半导体行业整体维持高景气增长态势，叠加晶圆及先进封装材料国产替代提速，公司锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，不仅在半导体封装领域实现对国外供应商的规模化替代，稳固国内市场的核心主力供应商地位，在高端先进封装和晶圆领域的市场开拓也取得成效，营业收入实现稳健增长。

2、报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长41.66%，主要系：（1）公司营业收入保持稳健增长。（2）公司先进制程电镀液产品持续放量增长，先进封装光刻胶亦在多家客户处实现规模化导入。业务正加速向先进制程、先进技术领域的高附加值材料延伸，产品结构持续优化，综合毛利率稳步提升。（3）公司锚定光刻胶、先进制程电镀液等核心“卡脖子”产品，研发投入力度持续增强，多项储备技术实现关键性突破。

3、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长30.12%，除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动影响以外，增长幅度低于扣除非经常性损益的净利润的增长幅度主要系报告期内理财收益及计入当期损益的政府补助占比较上期减少导致。

4、报告期内，公司总体销售收款情况良好，经营活动现金净流量与公司经营业绩相匹配。

五、核心竞争力的变化情况

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。作为国内半导体材料领域的领军企业，公司始终锚定关键电子化学品自主研发与产业化应用赛道，以技术创新为核心驱动力深耕行业多年。凭借持续高强度的研发投入与关键技术突破，公司已构建起覆盖半导体全产业链的材料解决方案体系，不仅在半导体封装化学

品领域实现对国外供应商的规模化替代，成长为国内市场的核心主力供应商，更在晶圆制造领域已实现深度卡位，通过电镀液及配套试剂、光刻胶及配套试剂两大核心业务板块，为先进制程芯片制造提供关键材料支撑，同时逐步向半导体显示及IC载板等高附加值领域延伸。目前，公司已成为国内少数具备半导体封装、晶圆制造和半导体显示全链条电子材料供应能力的企业，为我国半导体产业的自主可控发展提供关键支撑。

在电镀液及配套试剂领域，公司通过持续的技术创新，产品性能指标已达到国际一流水准，部分关键参数实现行业领先，成功打破国外厂商长期垄断的市场格局，成为行业的引领者。目前，公司电镀液产品已构建起丰富且极具竞争力的产品矩阵，在传统封装和先进封装领域均实现了全品类覆盖，并成功实现晶圆28nm、5-14nm先进制程等高端应用领域的市场突破。

光刻胶是半导体、新型显示微纳制造的核心交叉学科材料，集成高分子合成、精密纯化、微纳工艺、品质管控多重高壁垒技术，核心难点在于实现纳米级图形精度、ppb-ppt级超低杂质控制与大批量生产的批次一致性。行业产业化核心技术可凝练为五大核心体系，覆盖上游原料、中端配方、后端量产全链条，各环节高度耦合，共同决定产品制程适配能力与商业化水平。公司构建了从特色光刻胶、光刻胶核心原材料到配套试剂的完整研发制造体系，产品覆盖半导体全产业链应用场景，多项技术填补国内空白。

先进封装领域，公司凭借技术与产业积累，已构建起极具竞争力的光刻胶产品矩阵，涵盖可应用于GHI-line、I-line 光源的光刻胶产品，包括正性、化学放大型光刻胶及负性光刻胶，不同产品膜厚兼容7-300 μm ，在Bumping、RDL、TSV、fine pitch RDL、 $\mu\text{Bumping}$ 、 μPad 、MegaBumping等先进封装核心工艺环节，正稳步构建光刻胶全场景产业化覆盖能力。同时，公司正加速推进用于Bumping、WLCSP、2.5D/3D封装的PSPI的验证与量产，产品包括高温固化、低温固化、超低温固化系列，其中低温PSPI在客户端小量产中，具备低应力、高可靠性及高分辨率的PSPI产品在客户端验证中。公司目标成为国内先进封装光刻胶和PSPI领域的主力供应商，全面提升国产光刻材料的市场渗透率。

晶圆制造领域，具有化学放大效能的I-Line光刻胶系列产品及可应用于功率器件的PSPI已实现小批量供货，并同步在多家头部客户推广验证中。KrF光刻胶系列多款产品目前在开发及测试评估中，主要应用在逻辑芯片、存储芯片中。

半导体显示领域，公司OLED阵列用高感度PFAS Free正性光刻胶，已顺利通过了头部面板客户的验证，并取得小批量量产订单，在多家OLED显示客户端同步验证中；OLED阵列用高分辨率光刻胶在客户端验证中，另外公司在特色工艺光刻胶领域取得突破：负性光刻胶已成功拓展至玻璃基封装应用场景，获得头部客户量产订单。

综上，2026年上半年公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

公司围绕自身核心技术，基于产业发展及下游客户的需求，在不断提升技术与产品能力的同时拓宽产品品类，为客户提供更有竞争力的产品组合及整体解决方案。以创新驱动产品升级的能力持续增强现有客户粘度，巩固市场地位，以丰富经验及可靠的数据支撑和供应能力吸引新客户，开发新应用、开拓新兴市场领域。公司持续保持高水平的技术研发投入，配置先进设备，引进高端技术人才，坚持自主研发，提升公司产品和技术在行业内的领先水平。

截至2026年6月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的发明专利54项，实用新型专利7项，软件著作权1项；2026年上半年，公司研发投入4,549.37万元，同比增长49.55%，占营业收入的比例为13.15%，公司研发人员增至120人，同比增长30.43%，研发人员占员工总人数的比例为43.32%。报告期内公司荣获2025年度科技创新贡献突出企业。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2062号）同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票22,033,334股（每股面值人民币1元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为28.03元/股。本次发行募集资金总额为人民币61,759.44万元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为54,449.71万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15561号）。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	61,759.44
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	7,309.73
二、募集资金净额	54,449.71
减：	
以前年度已使用金额	43,766.92
本年度使用金额	1,836.65
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	2,115.20
银行手续费支出及汇兑损益	0.21
其他-注销募集资金账户利息余额转出	0.01
加：	
募集资金利息收入及现金管理收益	987.84
三、报告期期末募集资金余额	7,718.56

公司2026年上半年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2026年6月30日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职务/身份	直接持股数（万股）	直接持股比例	2026年上半年的质押、冻结及减持情况
1	张兵	董事长/实际控制人	2,664.4269	21.67%	无
2	蔡卡敦	实际控制人	958.6957	7.80%	无
3	向文胜	董事、首席执行官、首席技术官	21.0000	0.17%	无
4	陈小华	董事、总经理	124.0396	1.01%	无
5	杨一伍	董事	95.1059	0.77%	无
6	沈鑫	董事	-	-	-
7	李挺	独立董事	-	-	-
8	王嘉赋	独立董事	-	-	-
9	陈琳	独立董事	-	-	-
10	赵建龙	副总经理	66.1542	0.54%	无
11	程瑛	副总经理	-	-	-
12	徐栋	副总经理	-	-	-
13	李瑞媛	副总经理、董事会秘书	-	-	-
14	吕敏	财务总监	-	-	-

2026年上半年，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持的情形。

十、特别表决权事项（如有）

不适用。

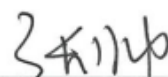
十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至2026年6月30日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：


石 伟


张 帅

华泰联合证券有限责任公司

